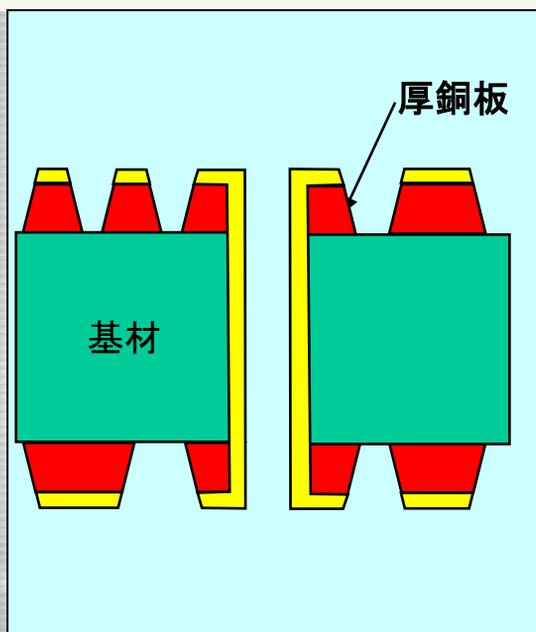


# 厚銅両面プリント配線板 高耐熱両面プリント配線板

## 厚銅両面FR-4プリント配線板



### <基 材>

R-1766/1661(パナソニック株)  
銅板厚...**200 $\mu$ m**  
(C1100-1/2H使用)  
スルーホールめっき厚...25 $\mu$ m

### <特 徴>

大電流対応  
高放熱対応

※UL非対応

## 高耐熱・高弾性率プリント配線板

項目	条件	単位	特性
Tg	DMA	°C	300
CTE	XY<Tg	ppm/°C	11~13
	XY>Tg		12~14
	Z<Tg		50~60
	Z>Tg		200~210
誘電率	1GHz		4.1
曲げ強度	25°C	MPa	450~510
曲げ弾性率	25°C	GPa	24~25

### <基 材>

CS-3305K(利昌工業株)  
色調...黒色  
板厚...0.1~1.6mm  
銅箔厚...18, 35, 70 $\mu$ m

### <特 徴>

高耐熱 高弾性率  
ガラス転移温度...300°C  
低熱膨張率  
ハロゲンフリー

※UL非対応

cgk

株式会社ちの技研

ISO9001  
認 証

ISO14001  
認 証